



## Tagesordnung

Thema:	59. Treffen des Arbeitskreises „Systemzuverlässigkeit von Aufbau- und Verbindungstechnologien“
Datum:	<b>Mittwoch, 15. Februar 2017, 10.00 Uhr</b>
Ort:	Fraunhofer IZM, Berlin, Gustav-Meyer-Allee 25, 13355 Berlin Gebäude 17, Raum 060ab (neuer Zugang im Erdgeschoss)
Teilnehmer:	AK-Mitglieder, Referenten

### Tagesordnungspunkte

- 1 10:00 Uhr  
Begrüßung, Erläuterung zur Tagesordnung  
*Herr Wüst, Fraunhofer IZM, Berlin*
- 2 10:10 Uhr  
Porenfrees Löten - Reflow-Löten ohne Gaseinschlüsse für CMOS-Sensoren  
*Herr Esch, WEPTECH GmbH, Nürnberg*
- 3 10:50 Uhr  
Zinnwhisker auf Leiterplatten – Konsequenzen für Sicherheitsbauteile  
*Herr Grommes, Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen  
Unfallversicherung (IFA), Sankt Augustin*
- 4 11:30 Uhr  
Elektrochemische Migration auf elektronischen Baugruppen durch kombinierte  
Lötprozesse  
*Herr Schimanski, Fraunhofer ISIT, Itzehoe*
- 5 12:10 Uhr  
Mittagessen

- 6            13:10 Uhr  
*Voidarmes Rework*  
*Herr Wolff, Ersä, Wertheim*
- 7            13:50 Uhr  
Passgenaue Schutzlackierung für sensible Elektronik  
*Herr Schwarzenbolz, Rehm Thermal Systems, Blaubeuren-Seissen*
- 8            14:30 Uhr  
Kaffeepause
- 9            15:00 Uhr  
2017 Alpha Engineering Material Developments  
*Herr Serzisko, Alpha Assembly Solutions, Langenfeld*
- 10           15:40 Uhr  
Alterung und Zuverlässigkeit: Eigenschaftsänderungen in polymeren  
Werkstoffen der Mikroelektronik  
*Herr Dr. Hölck, Fraunhofer IZM, Berlin*
- 11           16:20 Uhr  
Abschlussdiskussion  
*Herr Wüst, Fraunhofer IZM, Berlin*

**Ende der Veranstaltung gegen 16:30 Uhr**